



Crème à braser LP 5707

INTERFLUX®
ELECTRONICS N.V.



Fiche technique LP 5707

Ver: 3.11 30-09-15

Page 1

Crème à braser sans plomb, sans halogènes et sans nettoyage

Description

La crème à braser **LP 5707** est une crème sans nettoyage, sans halogènes et sans plomb qui a été développée pour le brasage sans azote et pour les hauts et longs profils de refusion .

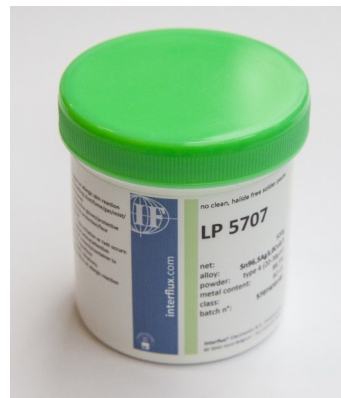
De plus, la crème produit extrêmement peu de microbilles.

La chimie est absolument sans halogènes. La chimie utilisée dans la crème **LP 5707** prévient le démouillage quand elle est soumise aux températures élevées et aux longs profils de refusion, même dans les process de brasage sans azote.

La crème à braser garde ses propriétés rhéologiques sur le pochoir, également dans des conditions de haute et basse humidité.

De plus, la crème **LP 5707** a été formulée pour minimiser la formation de « voids ».

La crème à braser **LP 5707** est classée **RO LO** suivant les normes IPC et EN.



La photo n'est pas contractuelle



Plus d'informations

Profil de refusion	P. 2
Recommandations pour le profil	P. 2
Manipulation	P. 3
Résultats des tests	P. 3
Recommandations pour les paramètres	P. 4

Avantages:

- Résistante aux hauts et longs profils de refusion même sans azote
- Prévient le démouillage.
- Grande stabilité sur le pochoir, même sous des conditions atmosphériques extrêmes
- Réduit le microbillage
- Réduit le « voiding »
- Résidus faibles et transparents après refusion
- Absolument sans halogènes

Disponibilité

alliages	pourc. metal.	granulométrie	conditionnement
Sn96,5Ag3Cu0,5	sérigraphie: 88,5%	Standard: classe 3 (25— 45µ)	pot :250g/500g
Sn95,5Ag3,8Cu0,7			cartouche:
Sn95,5Ag4Cu0,5	Dosage: 85%	Les classes 4 et 5 sont disponibles pour certains aliages	6Oz: 500g/600g/700g
Sn99Ag0,3Cu0,7			12Oz: 1kg/1,2kg/1,3kg/1,5kg
Sn98,5Ag0,8Cu0,7			seringue: 5CC/10CC/30CC
Sn95,8Ag4,2			autres conditionnements sur demande
Sn99,3Cu0,7			
Autres alliages sur demande			



Profil de refusion pour les alliages SAC, SnCu et SnAg

En général

La crème **LP 5707** est développée pour résister aux longs et hauts profils de refusion, également dans des conditions atmosphériques sans azote. Un profil de refusion de type linéaire ou avec un palier est possible. Des profils

avec un palier peuvent être utilisés afin de limiter les différences de températures du circuit surtout sur des cartes possédant une grande diversité de composants, ou bien, pour diminuer ou éliminer la présence de « voids ». En pratique, le profil

de refusion est surtout déterminé par la masse thermique et les propriétés physiques et les limitations des composants et du circuit. Il est important d'enregistrer le profil de refusion. Pour avoir une bonne appréciation de l'état ther-

mique de votre carte, utilisez des thermocouples pour enregistrer les températures. Mesurez sur des grands, des petits et des composants critiques en température situés sur les côtés, au milieu et à proximité de grandes masses thermiques.

Recommandations pour le profil (alliages SnAgCu, SnCu et SnAg)

La crème à braser **LP 5707** possède une large fenêtre de process avec peu de limitations. Ci-dessous vous trouverez quelques exemples de profils de refusion qui peuvent être utilisés. Il est recommandé de limiter le pic de refusion à 260°C et la durée du profil (de la

température ambiante jusqu'au pic) au-dessous de 8 min.

Préchauffage

De la température ambiante, il est conseillé de limiter la pente à 3°C/sec. Des montées en températures plus élevées peuvent détruire des composants en raison de l'humidité

absorbée.

Palier

En général entre 180°C -215°C et 0-120sec.

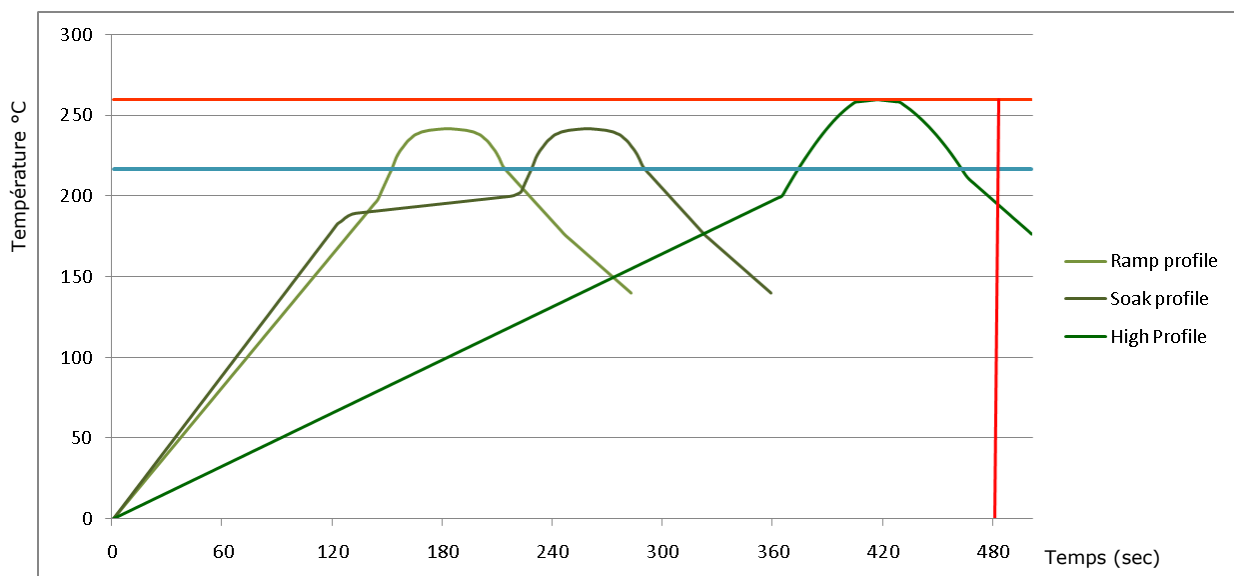
Refusion

Le pic de refusion est limité par les spécifications des composants et du circuit. Minimum 10°C au-dessus du liquidus de l'alliage est conseillé afin d'avoir un mouillage suffisant. En

général entre 235°C et 250°C. Le temps au-dessus du liquidus est en général entre 45 et 90s.

Refroidissement

Pas plus vite que - 4° C/s en raison de la différence du coefficient de dilatation thermique des composants.





Manipulation

Stockage

Stocker la crème à braser dans les pots hermétiques d'origines à environ 3° - 7°C.

Manipulation

S'assurer que la crème soit à température ambiante dans le pot fermé pour éviter la condensation de l'eau. Mélanger avant toute utilisation.

Sérigraphie

Assurer une bonne étanchéité entre la carte et le pochoir. N'appliquer pas plus de pression sur les racles que nécessaire, le pochoir après la sérigraphie doit être propre. Appliquer suffisamment de crème à braser sur le pochoir afin que la crème puisse rouler aisément pendant la sérigraphie. Rajouter de la crème à intervalle régulier.

Entretien

Un nettoyage régulier sous le pochoir est recommandé afin d'assurer une bonne qualité de sérigraphie. Le produit de nettoyage **ISC8020** est recommandé en lingettes ou en forme liquide.

Réutiliser la crème

Ne pas mélanger de la crème fraîche avec de la crème déjà utilisée. Ne pas remettre de la crème déjà utilisée

dans le réfrigérateur. Remettre l'opercule et fermer le pot avec le couvercle à l'abri de l'humidité. Faites un test de sérigraphie et refusion avant toute utilisation en production.

Sécurité

Toujours lire la fiche de sécurité du produit.

Résultats des tests de fiabilité

Conforme à la norme IPC J-STD-004A/J-STD-005

Propriétés	Résultats	Méthodes
Chimique		
Miroir de cuivre	passé	J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.32
Présence d'halogènes	aucune	J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.28.1
Argent chromate (Cl, Br)	passé	J-STD-004A IPC-TM-650 2.3.33
Classification du flux	RO LO	J-STD-004A
Environnement		
Test SIR	passé	J-STD-004A IPC-TM-650 2.6.3.3

Propriétés	Résultats	Méthodes
Mécanique		
Test de microbilles	après 15min	passé J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.43
	après 4h	passé J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.43
Test de mouillage		passé J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.45
Test d'effondrement	après 15min à 25°C	passé J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.35
	après 10min à 150°C	passé J-STD-005 IPC-TM-650 2.4.35



Recommandations et paramètres d'utilisation

Sérigraphie

Vitesse de sérigraphie: 20—150 mm/sec

Pression sur les racles: 250g—350g/cm

Température souhaitée: 15 à 25°C

Humidité souhaitée: 25 % à 90% h.r.

Assemblage CMS

durée du pouvoir collant ('tack time'): >8 heures

Test "in situ":

appropriée pour: "flying probe"
Planche à clous

Nom commercial du produit : LP 5707 No-Clean, Halide Free, Lead-Free Solder Paste

CLAUSE

Du fait qu'Interflux® Electronics N.V. ne peut pas prévoir ou contrôler les différentes conditions dans lesquelles ces informations et nos produits sont utilisés, nous ne donnons pas de garantie concernant l'exactitude de cette description ou l'aptitude de nos produits dans certaines situations données. Les utilisateurs de nos produits doivent effectuer leurs propres tests afin de déterminer que chaque produit convient à l'objectif fixé. Par conséquent, le produit en question est vendu sans cette garantie.

Copyright:

INTERFLUX® ELECTRONICS

Consultez la dernière version de ce document sur:

www.interflux.com/fr

Le document dans une autre langue?:

www.interflux.com